

檔 號：
保存年限：

210206

電子公文

華夏學校財團法人華夏科技大學 函

地址：(23568)新北市中和區工專路111號

聯絡人：機械系（通用）

聯絡電話：(02)89415100

傳真電話：(02)29415730

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年12月12日

發文字號：華夏教字第1030000995號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：邀請函（華夏3D列印技術實務與發展研討會-邀請函.DOC，共1個電子檔案）

主旨：敬邀參與本校103年度廣度研習活動—「3D 列印技術實務與發展研討會」，請 惠予轉知所屬踴躍參加，請 查照。

說明：

- 一、本校為配合教育部推動第二期技職教育再造「再造技優計畫」，培育設計製造技優人才與職場接軌，特舉辦旨揭活動。
- 二、本研習活動訂於103年12月19日假華夏科技大學A202國際會議廳舉行。
- 三、全程出席參與本研習活動者，將給予研習證明，敬請鼓勵貴校師生踴躍報名參加，並惠予出席人員公假，無任銘感。

正本：公私立大專校院、各公私立高級職業學校

副本：本校機械系

103/12/12
09:53:43

擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，

公告週知。

二、文陳閱後存。

校長 陳 富 都

專員王淑娟

103-12-15

副教授兼研發處
學務及推廣處處長 施君興

教授兼研發處
研發長 林佑昇

教授兼研發處
研發長 林佑昇

決代
行爲



研究發展處

華夏科技大學 103 年度廣度研習活動邀請函

一、活動目的：

本校為配合教育部推動第二期技職教育再造「再造技優計畫」-培育設計製造技優人才職場接軌計畫，促進學術交流，提高本校教學品質及研究水準，並拓展專業應用領域與產學合作機會，特舉辦本次「3D 列印技術實務與發展研討會」活動，邀請產業界製造廠商、專家人員與學者，透過專題演講方式與實作活動，進行研習與體驗，期使各校教師、學生與業界藉由研討活動，了解 3D 列印機的趨勢發展、未來應用可能，並能有更具積極務實的作法，有效增進教師參與學術研究及進行產學研發等相關機會。

二、指導單位：教育部

三、主辦單位：華夏科技大學機械工程系

四、協辦單位：創志科技顧問有限公司、華夏科技大學研究發展處

五、活動時間：103 年 12 月 19 日 09:00~16:30

六、活動地點：華夏科技大學 A202 國際會議廳

七、活動聯絡人：華夏科技大學機械工程系謝瑞玲小姐，聯絡電話:02-89415100 分機 3202，

email：candy@cc.hwh.edu.tw

八、交通資訊及位置圖：<http://www.hwh.edu.tw/files/11-1000-573.php>

